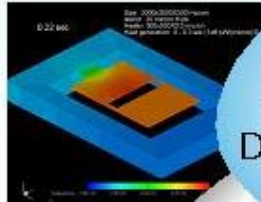


MEMS開発受託サービス

MEMS development services



開発・試作・生産受託



設計/解析
Design/Analysis

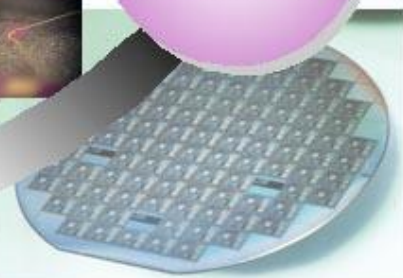
3次元微細加工
3D Fine Processing
4 & 6inch Line



少量生産
Pre Production

アイデア
(ユーザー)
Idea

大量生産
Mass Production
(OUT SOURCE)



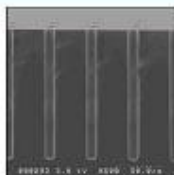
会社概要

社名: 株式会社メムス・コア (MEMS-CORE Co. Ltd.)
 資本金: 6,000万円 設立: 2001年12月
 代表者: 代表取締役 本間 孝治
 所在地: 宮城県仙台市泉区明通3-11-1 Tel: 022-777-8717 Fax: 022-777-8718

MEMS開発受託サービスの特徴

- ◇幅広いサポート力
単一工程は勿論のこと、デバイス設計・シミュレーション・原理試作・プロトタイプ試作・量産までをトータルでサポートいたします。また、外削ファブ、大学機関との連携により、競争力の強い価値あるサービスをご提供いたします。
- ◇多種多様なMEMS特有プロセスに対応
半導体プロセス技術ではなしえないMEMS製造特有のプロセス(マイクロマシニング)を保有します。
- ◇スピーディーな対応
お問い合わせ回答、見積り提示、プロセス提案、試作(加工)までをお待たせすることなく迅速に対応いたします。
お客様の開発LTに合わせ、より価値の高いサービスを提供いたします

要素技術の一例



DRIE加工
鉛錐膜形成



ステルスダイシング



TSV製作



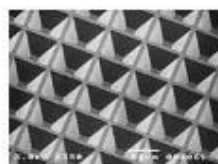
犠牲層エッチング



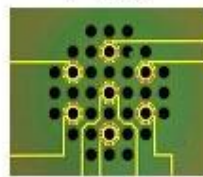
厚膜感光性DFプロセス



接合技術



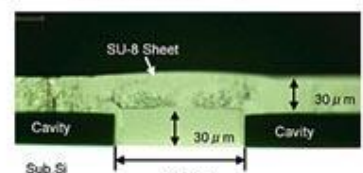
各種SIエッチング技術



複合配線パターン形成



3D構造形成



ラミネート技術

メムス・コアの試作プロセスメニュー

分類	工程	プロセス材料・装置
成膜	絶縁膜形成 (SiO ₂ , NSG, PSG)	酸化炉、AP-CVD、P-TEOS、
	金属膜形成 (Au, Pt, Cr, Ti, Cu, 他)	スパッタ、EB蒸着、めっき
フォトリソ	レジスト塗布 露光 現像	スピナー、スプレーコーター、ラミネーター、 両面アライナー、直接描画装置、パターンジェネレーター
	マスク製造(Crマスク)	GAD、パターンジェネレーター
エッチング	ドライエッチング (Si, SiO ₂)	Deep RIE、RIE、ICP-RIE、犠牲層(SiO ₂ , Si)、 イオンミリング、O ₂ アッシャー
	ウエットエッチング (Si, SiO ₂ , 各種金属)	TMAH, KOH, 各種金属膜エッチング液
接合	ウエハ接合	陽極接合、熱圧着接合、
実装	ウエハ切断	ブレードダイシングソー、レーザーダイシングソー
	ボンディング	ワイヤーボンダー
研磨	ウエハ研磨	CMP、CMP後洗浄
評価		干渉式膜厚測定器、触針式段差測定器、SEM、シート抵抗測定器、応力測定器、測定顕微鏡、レーザー顕微鏡
他ドライ処理	洗浄、表面改質	UV/O ₃ 処理、HMDS塗布

メムス・コアの開発・受託サービス

	コンセプト	詳細設計	試作	評価	量産(小規模)	
自主開発						PNセンサー AEセンサー
開発受託				★		★
共同開発	★	★		★		★
試作受託				★		★



:カスタマ



:メムスコア

★ :ご相談

株式会社メムス・コア

URL: <http://www.memscore.com/>

e-mail: info@memscore.com

TEL: 022-777-8717 FAX: 022-777-8718